

**特点:**
**图片**

- 输宽检测动态范围典型动态范围 21dB
- 宽频率覆盖 0.7~1.2GHz
- 产品无需供电
- SMT 封装: 8.13×8.13×3.05mm<sup>3</sup>
- 执行标准为 SJ20527A-2003

**性能参数:**

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位
			MIN	TYP	MAX	
频率范围	f	Z <sub>in</sub> =50 Ω	0.7		1.2	GHz
输入功率范围	P <sub>in</sub>	Z <sub>in</sub> =50 Ω	-6		+15	dBm
检测平坦度	ΔP <sub>SET</sub>	f=0.7~1.2GHz		2.0	3.0	dB
检测斜率	SLOPE	Z <sub>in</sub> =50 Ω f=0.7~1.2GHz R <sub>LOAD</sub> =10k Ω C <sub>LOAD</sub> =100pF Pin= -6~+15dBm	10	100	300	mV/dB
输出电压	V <sub>o</sub>		2.0		2500	mV
工作温度	T		-55		+85	°C
质量	t				2	g

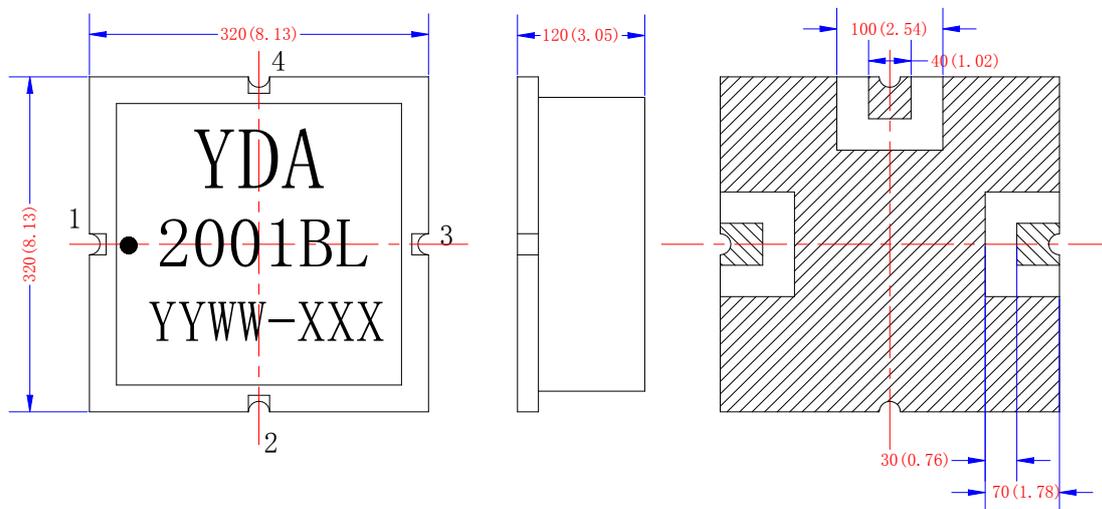
储存条件: 产品应储存在环境温度-10℃~+40℃、相对湿度≤80%、周围无酸性、碱性及其他有害气体的库房中。

**极限参数表:**

参数名称	极限值	单位
输入射频功率	+18.0	dBm
储存温度	-55~+100	°C

**封装外形图:**

单位: mil (mm) 公差: ±0.2mm



**字符标志:**

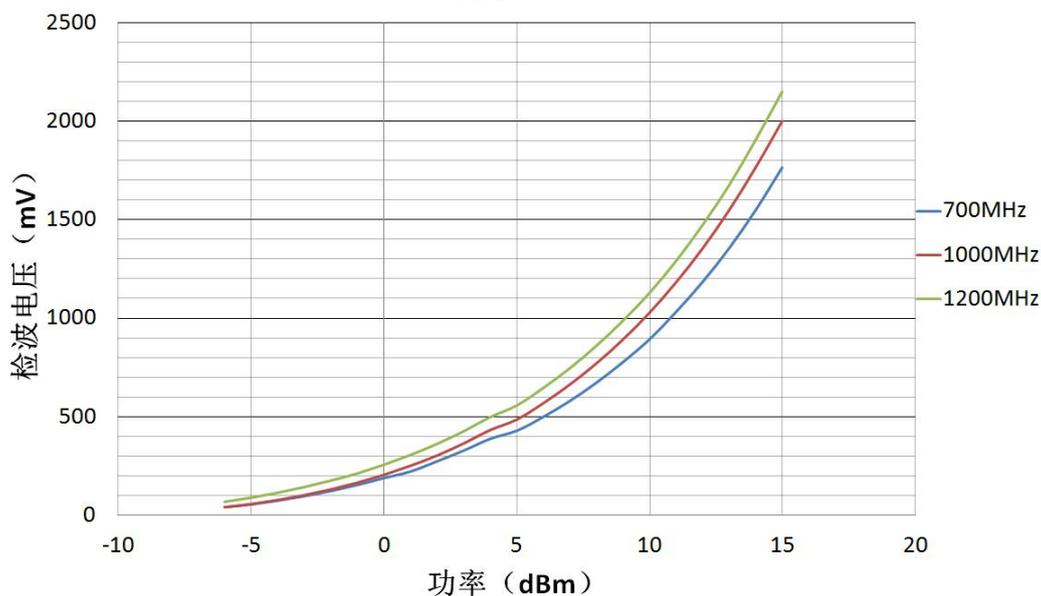
YDA2001BL	产品型号
●	1脚
YYWW	批次号
XXX	序列号

**引脚定义:**

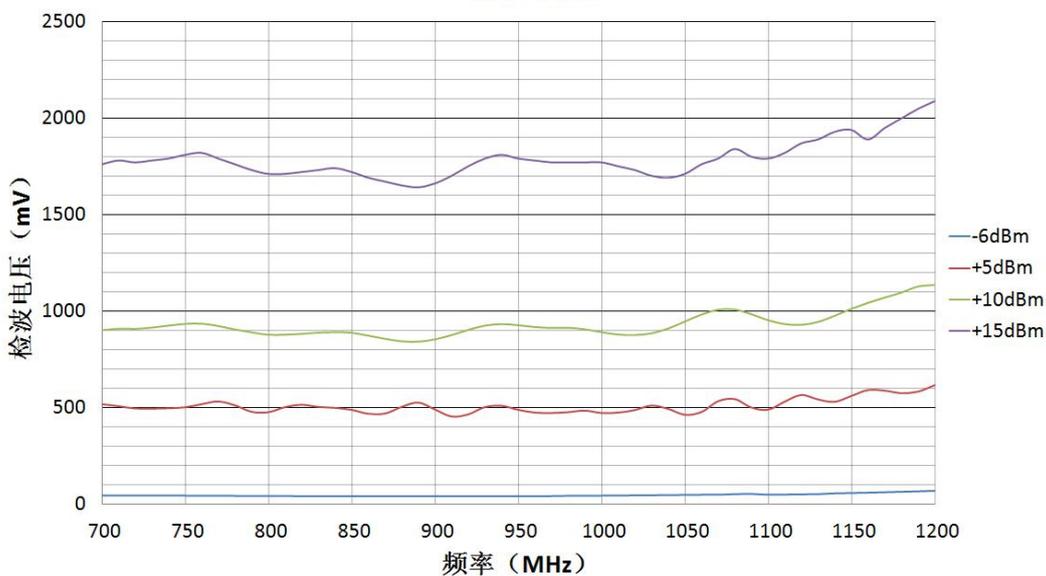
接口标识	接口说明	接口标识	接口说明
1	RF IN	3	VIDEO OUT
2	GND	4	GND

**测试曲线:**

功率VS电压

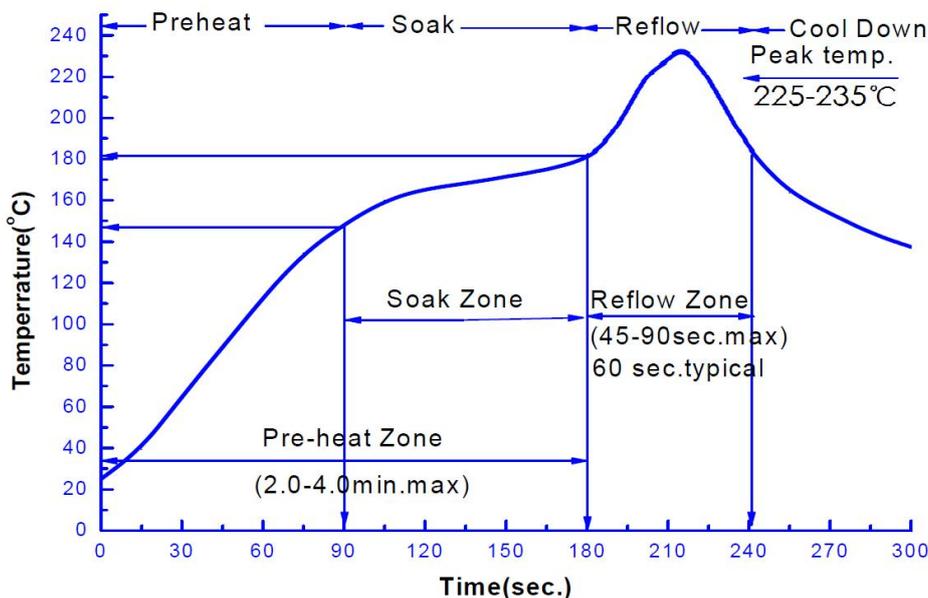


频率VS电压



### 产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
3. 对于采用 PCB+屏蔽罩组合封装的产品，如拆包后未使用完，需及时进行密封处理，如有包装有漏封，产品使用前建议按照 125℃，时间 4 小时进行烘烤，避免 PCB 因吸潮而导致 SMT 时 PCB 内部分层。
4. 产品焊接时请保证良好的接地（GND 引脚和底部金属化区域均需进行焊接），保证射频信号接地的同时，也保证产品机械固定的可靠性。
5. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 235℃。

6. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
7. 产品禁止采用超声波清洗，避免内部元器件及焊点受力出现开裂影响可靠性。
8. 印制板和屏蔽罩组合式的产品属于非密封器件，客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，保证产品上的缝隙及输入/输出孔口完全被覆盖，以提高产品耐环境适应性能力。
9. 其他产品相关使用注意事项依照《成都宇熙电子技术有限公司产品使用说明》相关要求执行。